

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML8

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2
A-RS-FR4-ML-0.30mm-035+035-TG150-HF	50200655	33	L2	3
		300		
		33	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	110		4
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		5
A-RS-FR4-ML-0.30mm-035+035-TG150-HF	50200655	33	L4	6
		300		
		33	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	110		7
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		8
A-RS-FR4-ML-0.30mm-035+035-TG150-HF	50200655	33	L6	9
		300		
		33	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		10
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	11

Dicke nach Verpressen

B00:

1490 µm

Tol+:

160 µm

Tol-:

160 µm

Dmax:

1650 µm

Dmin:

1330 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1600 µm

Tol+:

160 µm

Tol-:

160 µm

Dmax:

1760 µm

Dmin:

1440 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1456 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik